

114 年「半導體 IC 晶片封測製程技術菁英人才培育計畫」課程表

課程日期：114 年 7 月 17 日(四)~7 月 18 日(五)

課程地點：明新科技大學逢喜樓 209 教室、明新科技大學半導體人才培育基地 (新竹縣新豐鄉新興路 1 號)

報名網址：<https://forms.gle/jXWh6J3RfEPsDRav9>

課程內容：



| 日期 | 時間 | 課程單元主題/內容 | 授課教師 | 課程地點 |
|-------------|-------------|---|---|-------------------------|
| 7/17 (四) | 08:45-09:00 | 報 到 | | 明新科技大學 逢喜樓 209 教室 |
| | 09:00-10:00 | • 晶片戰~台灣的矽盾 AI與半導體 探討台灣半導體產業的崛起及其 在全球供應鏈中的關鍵角色 | 律芯科技股份 有限公司 薛宗智董事長 兼執行長 | |
| | 10:00-11:00 | • 全球半導體市場與趨勢解析 1. 一次看懂晶片產業 2. 半導體產業鏈介紹 | | |
| | 11:00~12:00 | • 揭開半導體的神秘面紗 你所不知道的半導體日常 | | |
| | 12:00-13:00 | 午 餐 | | 明新科技大學 半導體人才 培育基地 |
| | 13:00-17:00 | • 半導體封裝設備實務操作 1. 晶圓切割機操作實務 2. 打線機操作實務 3. 黏晶機操作實務 | 力成科技股份有限公司 林賢昇資深工程師 黃志賢資深工程師 明新科技大學郭人榮講師 | |
| | 17:00-18:00 | 綜 合 討 論 | | |
| 7/18 (五) | 08:45-09:00 | 報 到 | | 明新科技大學 逢喜樓 209 教室 |
| | 09:00-12:00 | • 積體電路封裝製程技術 1. 半導體封裝技術演變 2. 2D及3D封裝製程 3. 先進封裝工程概論 a. 晶圓級封裝(WLP)製程 b. 平板級封裝(PLP)製程 | 明新科技大學 半導體學院 趙守嚴副院長 | |
| | 12:00-13:00 | 午 餐 | | 明新科技大學 半導體人才 培育基地 |
| | 13:00-17:00 | 1. 半導體功率IC測試系統介紹 2. 半導體測試設備實務操作 a. 晶圓針測試機操作訓練 b. 電源IC元件測試機操作訓練 c. 高功率分離式元件測試機操作 訓練 | 美達科技公司 劉文正副理 明新科技大學郭人榮講師 | |
| | 17:00-18:00 | 綜 合 討 論 | | |